

UPWARDS

2026 SUMMER

日米半導体研究 インターンシップ 報告 & 懇談会開催

第1部 | インターンシップ報告会

米国3大学・国内2大学で短期半導体研究インターンシップを体験した学生20名が、現地での学びや経験を発表します。

第2部 | ランチ交流会

ランチを楽しみながら、体験者から研究や現地生活について直接話を聞くことができます。

「参加してみたい!」「少し興味がある!」

そんな方も大歓迎!ぜひお気軽にご参加ください。

派遣大学



バージニア工科大学



レフセラー工科大学



東北大学



ロチェスター工科大学



広島大学

日時

10月30日(FRI)

①10:00-12:00 ②12:00-14:00

場所

W-2 302講義室

出席
予定

金谷先生、井上先生、湯浅先生、他

九州大学 UPWARDS



参加登録受付中!

問合せ: 湯浅先生 hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp
UPWARDS事務局 upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp

報告を聞いた後は、参加者と
ゆっくりランチ懇談しましょう!

